

BOLION TECH

厦门市铂联科技股份有限公司（原名厦门新福莱科斯电子有限公司）成立于2003年1月23日，企业总投资8000万人民币，拥有面积24000平方米的洁净生产车间，FPC专用设备及精良检测仪器。月生产FPC和刚挠性结合板等优质产品16000平米以上。产品广泛应用于航天航空、汽车、医疗器械、通信、照相机、光电仪器仪表、电脑外设以及LCD等领域。

厦门市铂联科技股份有限公司系福建省柔性电子生产企业。现为中国印制电路板行业协会（CPCA）常务理事成员、厦门市高新技术企业、厦门市成长型中小企业。公司已通过ISO9001质量管理体系、TS16949汽车供应链管理体系认证、ISO13485医疗器械体系认证和ISO14001环境管理体系认证。FPC系列产品获得美国安全实验中心UL认证，并通过SGS检测鉴定符合RoHS&WEEE绿色环保的要求。

厦门市铂联科技股份有限公司专注于高密度多层柔性电路板与刚挠结合板的研发、设计、生产和销售。在产品品质控制和客户服务方面积累了丰富的经验，在业界建立了良好的信誉。公司严格推行各项标准化管理体系和技术，将以快的速度为您解决印制电路板差异化的需求。具备批量生产单面板/双面板/镂空板/多层板/分层板/刚挠性结合板的能力。

本文链接：[https://dqcm.net/wenan/bolion t-890819.html](https://dqcm.net/wenan/bolion-t-890819.html)